



Sie befinden sich hier: [Startseite](#) › **Förderung für Vorprojekt zum Bayerischen Chip-Design-Center (BayCDC)**

Förderung für Vorprojekt zum Bayerischen Chip-Design-Center (BayCDC)

19. September 2022

MÜNCHEN Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger stellt die Weichen für das Bayerische Chip Design-Center (BayCDC). Hiermit will Bayern das Fundament für die Chip-Entwicklung bündeln und ausbauen: „Die aktuellen Lieferengpässe im Halbleiter-Bereich zeigen uns, wie zentral Halbleiter-Chips heute für viele Industrie-Bereiche wie die Automobilindustrie sind. Hier müssen wir unsere technologische Souveränität weiter stärken. Bayern verfügt bereits über hervorragende Kompetenzen in Wirtschaft und Wissenschaft im Bereich Chip-Design. Diese wollen wir mit einem bayerischen Chip-Design-Center festigen und weiterentwickeln, das zudem eine Anlaufstelle für den Mittelstand werden soll. Die Zukunft der Halbleiter liegt auf dem Chip-Design und weniger auf der Produktion. Hier haben Taiwan und Südkorea bei der Fertigungstechnologie einen Vorsprung. Daher legen wir in Bayern den Fokus weniger auf die Fertigung als vielmehr auf die Vorstufe. Es ist Hochtechnologie nötig, um auf so kleinem Platz so komplexe Strukturen unterzubringen. Diese Zukunftstechnologie soll den Freistaat unabhängiger machen und bildet für das bayerische Wirtschaftsfundament des 21. Jahrhunderts eine weitere, stabile Säule. Chip-Design stellt eine Schlüsselkompetenz für den Halbleiter-Standort Bayern dar und ist ein zentrales Element der Bayerischen Halbleiter-Initiative. Die drei Fraunhofer-Institute sind für den Freistaat hervorragende Partner, um die Akteure und die Expertise beim Chip-Design zu stärken. Ich danke auch den Freien Wählern und der CSU, dass sie aus der Fraktionsreserve das Vorprojekt in Höhe von 1 Millionen Euro finanzieren. Damit wird die Grundlage für das Chip-Design-Center gelegt.“

Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger übergab gemeinsam mit Florian Streibl (FW) und Kerstin Schreyer (CSU) den Förderbescheid an die Fraunhofer-Gesellschaft. Die Federführung bei diesem Projekt hat das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen. Prof. Dr. Albert Heuberger, geschäftsführender IIS-Institutsleiter sagt über das Projekt, an dem die Fraunhofer-Institute für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC / Garching) und für Mikrosysteme und Festkörper-Technologien (EMFT / München) genauso beteiligt sind wie Hochschulen: „Mit dem Bayerischen Chip-Design-Center leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der Halbleiter- und Chipforschung im Freistaat und erhöhen die Attraktivität des High-Tech-Standorts Bayern weiter. Die Bündelung der Chipdesign-Kompetenzen des Fraunhofer IIS, Fraunhofer AISEC und der Fraunhofer EMFT, die Schaffung eines niederschweligen Zugangs zur Halbleiterfertigung und die Ausbildung von professionellen Fachkräften zählt auf die europäischen Bestrebungen zum Ausbau der Schlüsselindustrie Mikroelektronik ein. Diese sind nötig, um die technologische Souveränität Europas in Zukunft gewährleisten zu können.“

Das Zentrum soll für mittelständische Anwender von Halbleiter-Chips als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Das Hauptprojekt soll ab 2023 gefördert werden. Aktuell steht es noch unter Haushaltsvorbehalt. Das geplante Chip-Design-Center ist ein zentrales Element der Bayerischen Halbleiterinitiative, die das Bayerische Wirtschaftsministerium im Herbst 2021 zur Stärkung des Halbleiter-Standorts Bayern ins Leben rief.

Stv. Pressesprecher

[Pressemitteilung auf der Seite des Herausgebers](#)

[Inhalt](#)

[Datenschutz](#)

[Impressum](#)

[Barrierefreiheit](#)

